

最高法院民事判決

111年度台上字第1338號

上訴人 鈺緯科技開發股份有限公司

法定代理人 黃漢州

訴訟代理人 李宗德律師

劉昱劭律師

許芸瑋律師

被上訴人 友順科技股份有限公司

法定代理人 高耿輝

訴訟代理人 王怡惠律師

上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國111年1月19日臺灣高等法院第二審更審判決（110年度重上更一字第1號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決廢棄，發回臺灣高等法院。

理 由

一、上訴人之法定代理人已變更為黃漢州，有經濟部函可稽，茲據其具狀聲明承受訴訟，核無不合，先予敘明。

二、上訴人主張：

(一)伊於民國102年10月15日，向第一審共同被告晶偉電子股份有限公司（下稱晶偉公司，已確定）購買被上訴人生產，批次QHTG（下稱系爭批次）、型號LD1117AL-1.2V-A-Q之穩壓晶片2500個（下稱系爭晶片），同年12月3日交貨。伊於103年2、3月間，將之安裝於醫療等專業用途之顯示器，出售與訴外人臺灣三菱電機股份有限公司（下稱三菱公司）、日商JVC Kenwood Corporation（下稱JVC公司）、馬來西亞商Plexus Manufacturing SDN BHD（下合稱三菱等3公司）。

(二)三菱等3公司自103年6月起，陸續反應顯示器之螢幕（下稱

01 系爭螢幕)出現電壓異常等問題，伊轉知被上訴人，被上訴
02 人檢測上訴人退回系爭晶片2個、2個、3個後，依序於同年7
03 月18日、8月7日、9月29日出具客戶訴怨回答書(下稱系爭
04 客訴回答書)與伊，確認系爭晶片有鋁墊與焊點焊球結合不
05 完全之瑕疵(下稱系爭瑕疵)，並於103年8月20日出具保證
06 書(下稱系爭保證書)承諾賠償伊所受損害。

07 (三)依系爭保證書約定，求為命被上訴人賠償新臺幣11萬8812元
08 、美金7萬4097.5元、日幣923萬8821元，及各自105年5月18
09 日起加計法定遲延利息之判決(其他未繫屬本院部分，不予
10 論述)。

11 三、被上訴人抗辯：

12 (一)上訴人提出業已上錫使用之晶片供伊測試，系爭客訴回答書
13 並未表示全新未使用之系爭晶片有瑕疵。上訴人將系爭晶片
14 焊錫加工在其設計之螢幕電路板(主機板)上，經其百分之
15 百燒機測試後並無問題，足見系爭晶片並無瑕疵，系爭螢幕
16 電壓異常可能係上訴人加工、運送或三菱等3公司使用不當
17 等其他因素造成，上訴人不得請求伊賠償損害。

18 (二)系爭批次之晶片縱有瑕疵，最多僅64個，並非2500個均有瑕
19 疵，且上訴人提出之請求(折讓)單據、三菱公司聲明書，
20 未經JVC公司、三菱公司核章，不能據為其損害之證明。

21 四、原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴。理由
22 如下：

23 (一)上訴人於102年10月15日，向晶偉公司購買被上訴人生產之
24 系爭晶片，同年12月3日交貨。上訴人將系爭晶片焊錫加工
25 在其設計之螢幕電路板(主機板)上，經其百分之百燒機測
26 試後並無問題，復於主機板上組裝多種電子零件，施以多重
27 加工後，將系爭螢幕出售與三菱等3公司。三菱等3公司自10
28 3年6月起，陸續向上訴人反應，系爭晶片有電壓輸出不足之
29 瑕疵，上訴人乃轉知被上訴人，被上訴人依序受理上訴人退
30 回系爭晶片2個、2個、3個，並於同年7月18日、8月7日、9
31 月29日出具系爭客訴回答書等事實，為兩造所不爭。

01 (二)上訴人主張系爭晶片存有瑕疵，固提出系爭客訴回答書及訴
02 外人閱康科技股份有限公司報告（下稱閱康公司報告），暨
03 委任私立淡江大學電機系教授江正雄閱讀系爭客訴回答書後
04 提出專家意見書（下稱專家意見書）為憑，並舉江正雄之證
05 詞為據。惟專家意見書係上訴人於訴訟外自行委託江正雄所
06 撰寫，被上訴人復表示不同意專家意見書為證據，且江正雄
07 前於事實審已陳稱：未就系爭晶片做通電測試，亦未就系爭
08 晶片的共金層與其他晶片做對比性測試，故僅就系爭客訴回
09 答書提出意見等，故專家意見書及江正雄之證詞，不得作為
10 認定本件事實之證據。

11 (三)審酌系爭客訴回答書係針對客退品即上訴人使用過之系爭晶
12 片為分析，分析結果系爭晶片均呈現電性異常，表面有燒燬
13 現象，內部焊球與鋁墊未形成共金層，可推斷焊球在與鋁墊
14 結合時，中間金屬化合物生成有異常，可確定系爭晶片批次
15 為單一風險批次，並均記載可能原因為：1.W/B152號機台生
16 產期間有卡料並進行軌道清理的紀錄，產品卡料而未即時處
17 理會導致晶片表面氧化或汙染；2.產品卡料時，未將卡料品
18 放入氮氣櫃保存，導致晶片表面氧化；3.晶片鋁墊氧化或污
19 染會導致打線時鋁墊與焊球結合不良。佐以證人即被上訴人
20 工程師王啟任之證述、卷附上訴人員工寄給被上訴人員工之
21 電子郵件內容，足徵系爭客訴回答書僅表示系爭晶片客退品
22 可能有上述3種原因，並非表示系爭晶片存有瑕疵，亦難依
23 閱康公司報告，逕認該公司報告檢測之晶片即為系爭晶片。

24 (四)依證人即上訴人研發硬體經理盧俊宇、上訴人營運長謝冠彰
25 及王啟任之證述，足見系爭晶片歷經焊錫於主機板上、主機
26 板安裝於系爭螢幕上等多次加工程序，經檢測無誤始出貨與
27 三菱等3公司，待各該公司使用一段時間後方反應系爭螢幕
28 異常，則被上訴人辯稱系爭晶片係因事後加工、運送、使用
29 後始產生異常，尚非無據。上訴人並未舉證證明系爭螢幕異
30 常係因系爭晶片瑕疵所致，其主張系爭晶片之瑕疵初無跡象
31 ，縫隙係隨時間經過越來越大，最終導致晶片異常及螢幕故

障，無法依通常之燒機檢查方法發見，因此其受領系爭晶片無從即時發現系爭瑕疵云云，即乏所據。

(五)關於可否在晶片庫存品及客退品、原始生產紀錄與生產設備等相關物證均未留存下，單以系爭客訴回答書鑑定系爭晶片是否具有瑕疵、瑕疵之情形及如何造成，經函詢財團法人工業技術研究院（下稱工研院）及私立東吳大學李相臣教授，工研院函覆略以：造成晶片瑕疵之原因眾多，歉難單以系爭客訴回答書鑑定晶片瑕疵相關事宜，有該院函可參。李相臣則回覆：因各家晶片製程及使用晶片方式均不同，需要實體晶片製品（庫存品及客退品）相互鑑定，方可以客觀的立場解釋說明晶片究竟有無瑕疵、瑕疵情形為何及如何造成瑕疵？如無實體晶片製品，僅有8D（Discipline）報告，則可能需檢視8D報告內容而定，惠請提供關於晶片使用者（USER）的8D報告及生產者的8D報告，相互比對後，或許可以客觀立場瞭解晶片。但是科學建議：實際情形應以實體晶片製品及客退品之鑑定結果為準，因為各家晶片製程方式及使用晶片方式均不同，如無實體晶片製品，無法驗證8D報告內容等語，有民事陳報狀可佐。被上訴人雖聲請李相臣再為鑑定，然兩造既無法提出系爭晶片，核無必要。此外，上訴人復未能舉證證明系爭晶片具有瑕疵，其主張因系爭晶片瑕疵受有損害，請求被上訴人賠償，委無足取。

(六)從而，上訴人依系爭保證書約定，請求被上訴人給付新臺幣11萬8812元、美金7萬4097.5元、日幣923萬8821元各本息，為無理由，不能准許。

五、本院廢棄原判決之理由：

(一)按取捨證據、認定事實固屬第二審法院之職權，惟其採證、認事如與證據法則有悖，即難謂非違背法令，當事人自得以其採證、認事不當，據為第三審上訴之理由。

(二)系爭客訴回答書雖於表格中對W/B設備、人因素、晶片鋁墊部分，記載發生原因及分析點為可能原因（一審卷一41、211-1、227-1頁）；惟該客訴回答書均於生產紀錄調查敘明設

01 備卡料問題（同上卷42-1、212-1、228-1頁），而於最終「
02 經由上分析結果」內認：1.不良品經FIB分析結果判斷銅球
03 與PAD中間IMC生成有異常，導致焊球與PAD結合不全出現輕
04 微脫離現象。再經反查流程卡紀錄發現此批於W/B生產過程
05 最後一個料盒時出現卡料問題如4.4、4.3.5說明，由此判斷
06 人為因素未將該一條框架放入氮氣櫃中保存，導致產品在空
07 氣中暴露過久致使晶片表面氧化；2.由於產品晶片表面氧化
08 後導致1焊點焊球與晶片PAD結合不完全，產品在經客戶端SM
09 D製程下因熱應力不匹配，間接影響到打線點的原結合力形
10 成打點接合性改變，最終造成焊球界面微裂，導致客退品在
11 進行單體驗證時測試條件為輕載條件測試輸出正常，而加載
12 500mA測試輸出異常（同上卷43、43-1、213、213-1、229、
13 229-1）。佐以被上訴人於答辯狀自承：其測試後於103年8
14 月15日製作系爭客訴回答書表示上開兩顆晶片，屬其生產系
15 爭批次中因卡料導致電壓異常之晶片，然該批次生產數量共
16 122558件，若以最大值估計，亦僅可能產生64件瑕疵晶片。
17 申言之，因當時上訴人未能舉證出除上該兩顆晶片外，其他
18 晶片亦有瑕疵，故僅能就系爭批次晶片最大值估算等語（同
19 上卷136頁）。似此情形，是否不足以認定該測試之晶片確
20 有因被上訴人卡料導致晶片氧化，復致焊球介面微裂而有電
21 壓輸出異常之現象，即滋疑義，有待進一步釐清。原審未詳
22 予調查審認，遽為上訴人敗訴之判決，不免速斷，復有認定
23 事實與卷證資料不符之情形，亦有可議。

24 (三)上訴論旨，指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。末查，
25 本件事實未臻明瞭，本院尚無從為法律上之判斷。又所涉法
26 律上爭議，不具原則上重要性，爰不行法律審言詞辯論。均
27 附此敘明。

28 六、結論：本件上訴為有理由。依民事訴訟法第477條第1項、第
29 478條第2項，判決如主文。

30 中 華 民 國 111 年 7 月 27 日

31 最高法院民事第六庭

01					審判長法官	魏	大	曉
02					法官	李	文	賢
03					法官	林	玉	珮
04					法官	高	榮	宏
05					法官	李	寶	堂
06	本	件	正	本	證	明	與	原
07						書	記	官
08	中	華	民	國	111	年	8	月
								1
								日